

预浸液 S906

产品简介

其作用为于槽浴内，浸浴处理约 15~30 秒形成一层氧化膜，而膜不在金面沉积，保护金面。预浸效果受槽液中的有效成份浓度、槽液 pH 值、槽液温度、处理时间及基板作业状况（不同生产线的差异）等等因素影响。一般而言，预浸成膜会随这些变动因素的增减而增减；必须适当调整生产线的各项条件因素，以得到理想的成膜厚度。

操作条件

S906 50-90%(V/V 开缸量)

pH 11-13

Cu²⁺ < 20ppm

温度 5-35⁰C

处理时间 15—30 秒

配 槽（100L 建浴）

1. 将 20L 纯水放入槽。
2. 在搅拌情况下缓慢加入 S906（五倍浓缩液） 12L。
3. 加水至 100L，搅拌均匀。

槽液维护

1. S906 的有效成份浓度及 pH 值，会明显影响成膜速度。当有效成份浓度及 pH 数值偏高时，成膜速度也相对较快；需适度保持有效成份浓度及 pH 值的平衡状态，亦即有效成份浓度偏低时，pH 值可高些；有效成份浓度偏高时，则调低 pH 值。

地址：南通高新技术产业开发区金鼎路 26 号 E-mail：circuit01@pcbchemical.com

网址：<http://www.circuit-ele.com>

电话：0513-86102886 传真：0513-86102887

2. 随作业及处理时间的增长或是不当带入，槽液的铜离子浓度将会逐渐递增。当铜离子浓度累增到 20 ppm 以上时，将会造成明显的 S906 沉积于镀金层表面现象；

3. S906 槽液铜离子浓度测定：先行标定 1ppm、5ppm、10ppm 铜离子浓度的标准检量线，然后自槽液中取样 1ml，稀释 10 倍后，以原子吸收光谱仪检测铜离子浓度。

4. 基于设备与生产情况的差异，S906 槽液的有效成份浓度会因水分的蒸发而升高，或因主成份的消耗与水的带入而被稀释。若槽液的有效成份浓度升高，可加入纯水至 50 ~ 90 % 范围内；若槽液的有效成份浓度变稀，可加入原液调整浓度至 50% 以上。